

研究会 No. 54

めっきを科学 (サイエンス) に

ナノプレーティング研究会
第 29 回 (通算 93 回) 例会プログラム
特集: プリント基板 & 会社見学

<日時> 平成 21 年 4 月 23 日 (木) 13:00~17:00

<場所> 荏原ユーザライト株式会社 総合研究所 会議室

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木 2-4-3

TEL : 044-989-9250 FAX : 044-989-9260

ホームページ : <http://www.eu.ebara.com/company/overview.html>

○集合 12:45 現地集合 (小田急多摩線 黒川駅より徒歩 12 分 地図参照)

○黒川駅周辺にはレストランはありませんので、昼食についてはご注意願います。

<講演> 13:00~17:00

I. プリント基板関係

1. 13:00~13:40 (40 分)

電子回路基板及び業界の現状と課題

荏原ユーザライト株式会社 和嶋元世

2. 13:40~14:20 (40 分)

金属ナノ粒子による微細パターン形成技術

ハリマ化成株式会社 筑波研究所 松葉頼重

3. 14:20~15:00 (40 分)

スズめっきのウイスカについて

荏原ユーザライト株式会社 時尾香苗

4. 15:00~15:30 (30 分)

フリーディスカッション

II. 会社見学 (荏原ユーザライト株式会社 総合研究所)

5. 15:30~16:00 (30 分)

会社説明

6. 16:00~17:00

会社見学

内容 ; 実験室、精密機器室、排水処理場、など

17:00

現地解散

研究会参加費 : 当研究会会員無料、非会員 10,000 円

*参加申込 : FAXまたはE-mailで4月20日までに

連絡先 : 〒243-0037 厚木市毛利台 3-17-19 渡辺 徹

TEL & FAX : 046-247-0351

E-mail : nano_plating@yahoo.co.jp

ホームページ : <http://www.ne.jp/asahi/nano/plating/>

講演アブストラクト

1. 電子回路基板及び業界の現状と課題

荏原ユーザライト株式会社 和嶋元世

パソコン, 携帯電話等に代表されるモバイル機器や自動車の分野では, 半導体, 電子デバイス及びこれらを実装するエレクトロニクス実装技術の進展が著しく, 機器の小型・薄型化・軽量化・多機能化に大きく貢献している。このエレクトロニクス実装技術の中心となる電子回路基板には配線の微細化や高機能化が要求されている。本講演では日本の電子回路基板の技術開発動向及び業界の現状と課題について述べる。

2. 金属ナノ粒子による微細パターン形成技術

ハリマ化成株式会社 筑波研究所 松葉頼重

プリンタブルエレクトロニクスへの関心が急速に高まりつつある。この概念がフォトリソグラフィの競合技術以上の革新性をもたらすには、様々な印刷技術と機能性インクの開発が重要である。

ここでは、配線・接合の基礎材料である金属ナノ粒子インク的设计問題について整理し、インクジェットによるオンデマンド印刷を中心に応用事例を紹介したい。

3. スズめっきのウイスカについて

荏原ユーザライト株式会社 時尾香苗

環境問題から、従来の Sn-Pb めっきから Sn-Ag, Sn-Bi, Sn-Cu 合金めっきおよび Sn めっきへの変更がなされた。しかし、Pb フリー化されたことに伴い、ウイスカ発生という問題がクローズアップされるようになった。ここでは、当社で行ったウイスカの発生・抑制メカニズムの検討を述べるとともに当社ウイスカ抑制 Sn めっきプロセスおよび Sn-Ag めっきプロセスについて紹介する。